

MLCC行业景气度上行 企业发力高端市场

■本报记者 李万晨

近期,海外多家MLCC(多层陶瓷电容器)企业相继宣布调价。据最新市场消息,全球被动元件龙头国巨股份有限公司(以下简称“国巨”)自7月1日起对全系列产品线进行涨价,涵盖MLCC、铝电解电容、钽质电容等。

“近期,全球MLCC行业景气度持续提升,海外主流原厂密集发布调价通知,覆盖AI服务器、车规级及通用消费品全系列产品,其中供需紧张的高端高容规格涨幅达50%,行业正式步入由算力需求主导的全新景气周期。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

市场需求旺盛

MLCC被誉为“电子工业大米”,是各类电子设备必备基础被动元件,广泛应用于消费电子、通信、新能源汽车、算力服务器等领域。

北京科方得科技发展有限公司研究负责人张新原对《证券日报》记者表示,此前MLCC行业的增长高度依赖手机、家电等传统消费电子,存在周期波动大、景气持续性弱的情况。2026年以来,AI算力基础设施加速落地,叠加新能源汽车、高端通信需求共振,高容、高压算力专用MLCC市场需求爆发;行业呈现显著结构性分化,高端MLCC大幅弱化对传统消费电子周期的依赖,走出量价齐升的中长期结构性上行行情。

下游算力硬件迭代直接拉高单机用料需求,成为行业景气度扩张的直观印证。中研普华产业研究院6月22日发布报告显示,传统普通服务器MLCC单机用量仅约2000颗,8卡AI服务器用量可达约20000颗,英伟达GB300单机约需3万颗;最新Rubin平台VR200 NVL72单机用量从48万颗飙升至60万颗,增幅达25%。

旺盛需求推动涨价行情持续发酵。本轮MLCC调价中,高端算力专用产品涨幅最为突出。“本轮涨价已形成清晰的分层格局,行情分化进一步印证高端赛道景气度领先。”北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹敏分析。



2026年以来
AI算力基础设施加速落地,叠加新能源汽车、高端通信需求共振,高容、高压算力专用MLCC市场需求爆发

图片素材来源:新华社

集邦TrendForce数据显示,目前通用消费级MLCC涨幅区间稳定在20%至40%,适配AI服务器、新能源汽车的高容高频主力料号涨幅突破40%。

供给端刚性约束进一步放大供需缺口。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示,当前高端MLCC需求持续扩张,但产能扩容存在极强刚性约束,供需紧张格局或将长期延续。高端高容MLCC生产线从建设到稳定量产完整周期为1.5年至2年;超薄介质流延机、高精度叠层机等核心设备供给高度集中,仅少数海外厂商具备制造能力,设备交付周期漫长,行业短期难以形成充足稳定的高端产能匹配市场增量。

上市公司加速抢占市场

国内MLCC产业链上市公司正加速布局高端市场,通过核心技术

攻坚、高端产能扩建、绑定头部优质客户等多重举措,全力抢占AI服务器、车规级高端MLCC市场份额,行业集中度持续提升。

在技术自主化领域,国内头部企业实现关键突破。广东风华高新科技股份有限公司此前在业绩说明会活动记录表中提到,2026年一季度,公司关键材料自主化取得显著进展,车规级MLCC高可靠瓷粉、丝印浆料、汽车电子端电极铜浆三大核心材料攻坚实现新突破,产品迭代成效突出,3款MLCC产品完成客户编码认定并批量交付,7款高容新品有序研发,广泛适配新兴市场领域客户。

产能升级方面,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司6月16日公告称,公司全资子公司斯迪克新型材料(江苏)有限公司拟以自有资金及自筹资金在泗洪经济开发区投资建设年产12万平方米高端MLCC离型膜项

目。项目建成投产后,将有效突破公司现有产能瓶颈,大幅提升MLCC离型膜整体产能。

苏州均家电子科技股份有限公司6月25日公告称,公司控股子公司拟投资高性能多层片式陶瓷电容器生产项目。本项目拟投资总额为15亿元(最终以实际投资额为准),计划分两期进行。该项目主要通过新增生产线、优化生产布局以提升公司MLCC产品整体供给能力,进一步提升生产规模以满足市场需求,助力公司强化MLCC业务的市场优势,推动业务规模与盈利能力持续提升。

广东村创科技有限公司总经理何永基表示,国内上市企业持续深耕AI服务器、车规级高端MLCC赛道,逐步补齐高端产品技术、产能短板,缩小与国际巨头的差距。长期来看,本土头部厂商在高端赛道的市场份额、产品附加值有望持续提升。

TGV玻璃基板赛道热度上升

■本报记者 李雯珊
见习记者 张美娜

自全球光纤与特种玻璃龙头企业康宁在6月底正式发布Glass Bridge(玻璃桥)技术以来,市场对TGV(玻璃通孔)玻璃基板的关注度持续提升,产业链上市公司集中披露研发、制造与送样进展,覆盖上下游多个环节。

7月2日,京东方科技集团股份有限公司在接受机构调研时表示,公司已实现高深宽比TGV等玻璃封装封装板全流程工艺打通,拥有完备玻璃封装板制造工艺能力,并已完成大尺寸、高层数玻璃基板封装开发和送样,且现已通过Pre-con(预处理测试)等多项可靠性标准测试。此外,公司和康宁依托在光学材料与连接产品领域的专长,在玻璃封装封装板、光互连相关应用方面,打通从材料、制造到应用的关键环节,提升先进封装整体制造能力与良率,同时共同探索光引擎集成方案与系统级方案验证。

国研新经济研究院副院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示,康宁“玻璃桥”技术落地,标志着玻璃基板从传统显示耗材升级为AI算力、高速光互连的核心载体。叠加高带宽内存、扇出型面板级封装产业需求爆发,玻璃封装封装板赛道进入从技术验证向商业化落地过渡的关键期。对比传统有机封装与硅中介板,玻璃基板具备低介电损耗、低热膨胀、可做大尺寸高层数布线等优势,完美适配1.6T、3.2T高速光模块与高端算力芯片封装需求。

在中游玻璃封装封装板制造环节,多家上市公司已打通完整TGV工艺链路。例如,杭州美迪凯光电科技股份有限公司近期在接受机构调研时表示,公司已开发TGV核心

工艺,同时还开发了孔内壁镀膜、电镀、CMP(化学机械抛光)工艺,以实现微孔金属化与产品表面平坦化;叠加平面RDL(重布线层)电性互联工艺,现已构建起完整的TGV全流程制造能力。

此外,亦有多家上市公司相关业务处于验证阶段或已产出样品。深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司近期公告显示,公司玻璃基板研发项目聚焦工艺能力研究与设备评估,目前处于技术储备阶段并成功研制出样品。

设备端多家企业也完成了技术迭代,武汉帝尔激光科技股份有限公司通过投资者互动平台表示,公司TGV激光微孔设备主要面向玻璃基板精密通孔加工,目前已实现晶圆级、面板级设备交付,全面布局半导体先进封装、新型显示相关领域。

苏州德龙激光股份有限公司近期披露的公告显示,TGV相关产品已形成销售,但现阶段行业整体仍以研发验证、小批量试产和工艺优化为主,未来能否获得批量订单,仍存在较大不确定性。

业内人士认为,TGV高深宽比通孔填铜、RDL多层布线光刻对准、层间结合力控制、超薄玻璃切割等工艺仍存在全球共性难题。国内企业虽实现样品突破,但规模化量产良率提升周期较长,若工艺迭代不及预期,产业商业化节奏存在变数。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》记者表示,当前国内多数企业仍处于样品送样、小批量试产阶段,规模化量产、稳定盈利尚需时间,短期业务营收占比普遍偏低;高端半导体玻璃原片、高精度TGV设备、核心工艺配方仍存在技术壁垒,行业良率提升、成本下探仍需产业链长期协同攻关。

鹏鼎控股拟定增募资不超96亿元 抢抓AI算力基础设施建设红利

■本报记者 丁蓉

7月3日晚间,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)披露定增预案,拟募资不超过96亿元,全额投向AI(人工智能)服务器和高速光模块高密度互连封装项目。

鹏鼎控股相关负责人向《证券日报》记者表示:“PCB(印制电路板)作为AI算力系统的‘神经中枢’,是AI服务器、高速光模块等硬件的核心互连载体与基础支撑。为积极把握人工智能产业爆发的历史性机遇,抢抓AI算力基础设施建设红利,公司拟通过本次再融资,聚焦高端PCB产能扩张与技术升级。募投项目将新增约65.56万平方米高阶HDI(高密度互连板)年产能,助力公司突破产能瓶颈,强化技术壁垒,优化产品结构,全面对接全球头部客户需求,巩固行业龙头地位。”

根据公告,鹏鼎控股此次募投项目位于江苏省淮安市淮安经济技术开发区,该项目依托鹏鼎控股现有产业园厂房并拟新建厂房及配套公用设施,将引进成型设备、镀铜设备、钻孔设备、压合设备、自动化设备、防焊设备、品保设备等先进生产设备,并配置高素质的生产、技术、管理人员,打

造面向AI服务器和高速光模块的高阶PCB智能化生产基地。

鹏鼎控股方面表示,技术、订单和人才三大核心优势是项目落地的关键支撑。

技术储备方面,鹏鼎控股具备6阶以上HDI稳定量产能力,并且提前攻克高频材料、高密度散热等算力PCB核心工艺,配套产学研平台持续迭代前沿技术。

客户订单方面,鹏鼎控股高阶算力板已通过全球云厂商、光模块龙头企业认证,现有产线持续满产,新增产能可快速承接下游增量订单,产能消化确定性较强。

人才体系方面,鹏鼎控股在全球拥有4.7万余名专业员工,强大的材料、化工、精密制造复合型研发与生产团队,能最大限度保障项目建设、投产、良率爬坡全周期人才供给。

香港中文大学(深圳)高等金融研究院客座教授郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前,全球AI算力建设浪潮方兴未艾,为PCB行业发展带来广阔市场空间。头部上市公司加码高端产能建设,将优化产品结构,不仅有利于提升企业自身实力,也有助于进一步夯实我国PCB产业在全球产业链中的地位。”

时代新材签署30.34亿元风电叶片大单

■本报记者 肖佳

7月3日晚,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)披露重大经营合同公告,公司于4月1日至6月30日期间,集中与海内外多家风电主机厂签署叶片销售合同,含税总金额达30.34亿元。订单覆盖海上、陆上叶片产品,国内海外市场同步放量,为公司风电主业增长筑牢基本盘。

公告显示,本次30.34亿元订单拆分清晰:国内市场合计27.1亿元,其中16MW海上风电叶片订单2.39

亿元,6MW至10MW陆上大兆瓦叶片订单24.71亿元;海外陆上4MW至6MW叶片配套订单3.24亿元,形成了海陆并进、内外联动的订单结构。

时代新材董事会秘书夏智向《证券日报》记者表示:“我们看好国内风电行业长期发展空间。风电行业大型化、轻量化、绿色化发展趋势明确。海上风电、海外出口两大赛道增长动能充沛。”

夏智表示,本次集中落地30余亿元叶片订单,是市场对时代新材叶片技术、交付产能与综合服务能力的直

接认可。时代新材深耕风电叶片多年,搭建起完整大兆瓦叶片研发体系,主力机型均实现稳定量产,碳纤维复合轻量化方案有效提升机组发电效率。同时,公司国内多基地协同投产,海外工厂布局稳步推进,可灵活匹配国内陆上、海上项目以及海外客户交付需求。

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保教授向《证券日报》记者表示:“风电产业链条长、配套环节多,龙头企业持续锁定中长期订单,既能向上游拉动复合材料、树脂、玻纤等原材料产业的稳定投产,又能向下游

支撑整机厂商的项目落地,有效抑制产业链供需波动,稳定行业整体投资预期。”

曹二保进一步分析,国内陆上风电扩容、深远海风电规模化开发,叠加海外新能源转型需求,风电叶片市场中长期需求具备确定性。以时代新材为代表的本土叶片企业,依托自主核心技术、规模化先进产能同步开拓海内外市场,既能巩固国内新能源装备的技术优势和产能优势,也能借助出口业务提升我国风电装备的全球竞争力,带动区域高端装备制造产业集群提质升级。



经济日报社主管主办
证券市场信息披露媒体

创造 发现 分享

中国价值新坐标

广告